

薄膜ピエゾアクチュエータにおける振動板クラックと端部焼損の原因解析・対策提案

Cause Analysis and Countermeasure Proposal for Diaphragm Cracks and Edge Burnout in PZT Thin-Film Actuators

三溝 真一 (Shinichi Samizo)

独立系半導体研究者 (元セイコーエプソン) / Independent Semiconductor Researcher (ex-Seiko Epson)

Email: shin3t72@gmail.com GitHub: <https://github.com/Samizo-AITL>

Abstract---和文要旨 本研究は、Epson μ TFP (薄膜 PZT, d_{33} 駆動) アクチュエータの量産工程で顕在化した (1) 振動板クラックと (2) セグメント端部焼損の二課題を対象に、原因解析と対策評価を行った。クラックはウエハ面内で同心円状に分布し、断面観察で PZT 多層の特定層にボイドが局在することを確認した。これは外気由来成分の吸着による表面疎水化により、ゾルゲル塗布時に気泡が巻き込まれて層内ボイドが形成されたことに起因する。酢酸系溶媒によるプレウェット処理を追加し、表面を親水化して気泡巻き込みを抑制することで、不良率を 10.0% から 2.0% へ低減し、量産条件として確立した。一方、端部焼損は COM 下電極 (Au 配線) と VBS 上電極が最接近する PZT 側壁露出部に集中し、最大 40 V 印加および台形波立ち上り過渡電流 ($I = C \, dV/dt$) に伴う局所電界集中を起点として絶縁破壊が生じることが示唆された。恒久策として ALD- AlO_x による側壁パッシベーションを提案した。以上により、薄膜 PZT に固有の欠陥発生連鎖を明確化するとともに、親水性リセットと側壁パッシベーションの二本柱からなる、一般化可能なプロセス指針を提示した。

Abstract (English) —This study investigates two reliability issues in mass production of Epson μ TFP (thin-film PZT, d_{33} mode) actuators: (1) diaphragm cracks and (2) edge burnout. Cracks exhibited a donut-shaped wafer distribution, and cross-sectional analysis revealed voids localized in specific PZT layers. The mechanism was traced to surface hydrophobicity caused by airborne adsorption, leading to bubble entrapment during sol-gel coating. An acetic-based pre-wet treatment restored hydrophilicity, suppressed bubble entrapment, and reduced the defect rate from 10.0% to 2.0%, establishing a stable production condition. Edge burnout localized at exposed PZT sidewalls where the COM bottom electrode (via Au routing) approaches the VBS top electrode; up to 40 V bias and trapezoidal-wave transients ($I = C \, dV/dt$) induced local dielectric breakdown through field concentration. As a permanent countermeasure, ALD AlO_x sidewall passivation was proposed. These findings clarify thin-film-specific failure chains and present a dual-process guideline: (1) hydrophilicity reset and (2) sidewall passivation, both broadly applicable to ferroelectric MEMS reliability design.

Index Terms---和文キーワード — インクジェット, MEMS アクチュエータ, PrecisionCore (μ TFP), 薄膜 PZT, d_{33} 駆動, 信頼性, アセティック系プレウェット, 側壁パッシベーション, 端部焼損, クラック

Keywords — Inkjet printing, MEMS actuator, PrecisionCore (μ TFP), Thin-film PZT, d_{33} mode, Reliability, Acetic-based pre-wet, Sidewall passivation, Edge burnout, Cracks

I. 序論

インクジェットプリントヘッドは、解像度・速度・信頼性の高度化要求に応じて進化してきた。Epson 体系では、1990 年代の Mach ヘッド (バルク積層 PZT, d_{31} 駆動) が銀塩写真

の置換を牽引した [1]。2007 年には TFP (Thin Film Piezo) ヘッドの量産化 [2] によって、ピエゾの自前製造 (内製) と MEMS 一体加工への転換が始まった。その到達点として、2012 年に PrecisionCore (μ TFP) ヘッドが製品化され、ビジネスインクジェット分野でレーザープリンタの置換を本格化させた。

この技術的跳躍は、材料を「買って使う」方式から「作って最適化する」方式へのパラダイム転換に他ならない。しかし薄膜ピエゾの高電界・高密度駆動は、バルク素子では顕在化しなかった量産上の課題を露呈させた。すなわち、(i) 外気付着成分による表面疎水化を起点としてゾル塗布時に気泡が巻き込まれる振動板クラック、および (ii) COM-VBS 近接部の PZT 側壁露出で電界が集中して発生する端部焼損である。前者はプロセス環境・表面化学の管理課題、後者はデバイス構造と過渡電流 ($I = C \, dV/dt$) が重畳する信頼性課題として顕在化した。

本論文の目的は、PrecisionCore μ TFP ヘッドの基盤技術確立に至る過程で直面した上記二課題の原因を量産データと不良解析に基づき同定し、(A) 酢酸プレウェットによる表面親水化処理と、(B) ALD- AlO_x 側壁パッシベーションによる絶縁保護という二本柱の対策を提示・評価することである。(A) はウエハ工程における対策として、12 ロットの量産ウエハ評価で不良率を 10.0% から 2.0% へ低減し、量産条件として確立した実装策であり、(B) は露出側壁の局所耐圧を補強し、高電圧駆動時の信頼性を向上させる恒久策として提案する。

本稿の貢献は三点に要約される。

- 1) **Mass-production dataset & failure-chain mapping** : 薄膜 PZT 特有の欠陥発生連鎖 (外気付着 → 疎水化 → 気泡捕捉 → 層内ボイド → クラック) と、端部焼損の電界集中と過渡加熱の重畳機構を工程と構造の両面から体系化した。
- 2) **Hydrophilicity reset by acetic pre-wet** : 酢酸プレウェット処理により表面親水性を回復させ、12 ロットの量産ウエハ評価において不良率を 10.0% → 2.0% (約 80% 低減) と実証した。
- 3) **Uniform ALD sidewall passivation for insulation protection** : 設計上不可避な側壁露出に対し、均一成膜で露出部を被覆し、局所絶縁破壊を防止する恒久策を提示した。

以降、§2 でデバイス・プロセス構成を述べ、§3 で薄膜 PZT アクチュエータの課題を整理、§4 以降で個別解析と対策を

詳述する。本論文の一部内容は著者による技術報告書 [3] に基づく。

II. デバイス・プロセス構成

本研究対象のアクチュエータは、シリコン基板上にゾルゲル法で形成した多層 PZT 薄膜を駆動層とする積層型構造を有する。量産ラインのウエハ工程における層構成および代表寸法を以下に示す。

A. 層構成

基板は (111) 方位 Si ウエハであり、裏面にキャビティを形成して振動板領域を確保した。基板表面には高耐圧化を目的として ZrO_2 絶縁層 (400 nm) を堆積し、その上に下部電極を構築した。下電極は Pt(111) (80 nm) を主材とし、Ir 酸化防止層 (10 nm) および Ti シード層 (4 nm) を介して結晶配向性と密着性を確保した。さらに、PZT 第 1 層焼成後に Ti 薄膜 (4 nm) を挿入し、組成傾斜を補正して結晶成長を均一化した。

PZT 薄膜は $\text{Pb}(\text{Zr,Ti})\text{O}_3$ 組成を有し、1 層あたり 200 nm の膜厚でスピコート～RTA 焼成 (740 °C) を 6 回繰り返すことにより、合計 1.2 μm の駆動層を形成した。上部電極は Ir/Ti (10 nm/10 nm) 構成とし、電気化学的安定性と応力緩和を両立させている。

B. アクチュエータ構造

アクチュエータは、Si キャビティ上に形成された薄膜 PZT 振動板を駆動素子とする単層セグメント型構造である。各セグメントの主要寸法を以下に示す：

- セグメント幅：70 μm
- セグメント長：800 μm
- 振動板厚：PZT 層 1.2 μm , ZrO_2 絶縁層 0.4 μm
- 配線層：Au/NiCr (1300 nm/50 nm)
- キャビティ幅：70 μm

1 チップあたり 2 列構成で、各列に 300 セグメントを有する (計 600 ノズル)。各列は COF (Chip on Film) 実装のドライバ IC により独立駆動される。COF 側の配線は Au/Cu (0.5 μm / 8 μm) の二層構成とし、アクチュエータ側の NiCr/Au パッドとはノンペースト導電接合 (Non-Paste Conductive, NPC) コンプレッションボンディングにより電氣的に接続される。この方式は導電ペーストを用いず、金属間の直接圧接によって低抵抗かつ高信頼な導通を得るものである。

C. ドライバ IC との統合

ドライバ IC は CMOS 0.35 μm プロセスで製造され、標準電源 3.3 V、高耐圧出力 45 V に対応する。300 チャネル×2 列構成 (計 600 出力) で、300 dpi クラスの高密度ノズルアレイを並列駆動する。COF 実装による柔軟な応力吸収と、NPC 圧接によるペーストレス低抵抗接続を組み合わせることで、高電圧駆動下でも安定した信号伝送と長期信頼性を両立した。

D. アクチュエータ特性

薄膜 PZT の材料特性を X 線回折 (XRD) および電気特性から評価した結果、(100) 配向率は約 90% であり、以下の式で算出した：

$$R_{(100)} = \frac{I_{(100)}}{I_{(100)} + I_{(110)} + I_{(111)}},$$

ここで $I_{(hkl)}$ は各回折ピークの積分強度を示す。高い $R_{(100)}$ 値は結晶配向性および膜質の均一性が良好であることを示している。

また、印加電圧 40 V、PZT 膜厚 1.2 μm の条件下で最大分極 $P_m = 42 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ を示した。このときの電界強度は $E = V/t = 40 \text{ V}/1.2 \mu\text{m} \approx 0.33 \text{ MV}/\text{cm}$ であり、高い分極値と良好な (100) 配向は d_{33} 駆動モードにおける優れた電気機械結合を示す。その結果、振動板の初期変位量は約 800 nm に達した。

さらに、代表サンプルによる 180 億ショット耐久評価 (常温・連続駆動条件) においても、変位低下量は 5% 以内であり、 μTFP アクチュエータは材料レベル (結晶配向・分極特性) と構造レベル (振動板設計・実装構成) の両面で、高い信頼性と安定した吐出駆動性能を有することを確認した。

III. 薄膜 piezo アクチュエータの課題

薄膜 PZT を用いた μTFP アクチュエータは、高密度かつ高応答な駆動を可能にする一方で、薄膜化および微細加工に伴う新たな信頼性課題を内包している。量産ウエハ工程において顕在化した主要な不具合は、以下の二つに大別される。

- 1) 振動板クラック：ゾルゲル成膜時に形成された膜内ボイドが応力集中点となり、ウエハ面内で同心円状に分布するクラックが生じる現象。成膜表面が外気吸着により疎水化し、スピン塗布中にゾルが滞留して気泡を巻き込むことが主因と推定された。
- 2) 端部焼損：COM 下電極と VBS 上電極が近接する領域で、PZT 側壁の露出部に局所電界が集中し、絶縁破壊および炭化痕を伴う焼損が発生する現象。高電圧駆動時に過渡電流 ($I = C \text{ d}V/\text{d}t$) が重畳することで電界集中が強調されることが要因である。

これらの不具合はいずれも、薄膜 PZT アクチュエータに特有の「表面化学的要因」と「構造的要因」が複合的に関与しており、電気・応力・化学反応が相互に影響する複合故障モードとして発現する。すなわち、(i) 表面汚染による濡れ性劣化が膜内に応力集中点を形成し、(ii) 側壁露出による電界集中が耐圧限界を低下させる、という二系統の課題が、量産安定性を阻害する主要因である。

IV. 振動板クラックの解析と対策

A. 現状把握

ユニットスクリーニングで抽出した不良チップを解析したところ、ウェハ半径の中間域に同心リング状に分布していることが確認された。断面 TEM では、6 層 PZT のうち特定の層に局所的な空隙 (ボイド) が形成されており、EDX では炭素由来成分が検出された。(Fig.1) 処理履歴の追跡により、特定の RTA 装置で処理されたウエハに限定して発生しており、その装置天井部には外気排気口が存在していた。

さらに、同装置で長時間滞留させたウエハを用いて PZT 塗布・焼成を行い、反射条件を最適化した表面検査を実施したところ、PZT 内部ボイドに起因すると考えられる同心円状の欠陥分布が再現された。(Fig.2)

TABLE I
μTFP アクチュエータウエハの層構成（下層→上層）
LAYER STRUCTURE OF μTFP ACTUATOR WAFER (BOTTOM → TOP)

層構成 / Layer	材料 / Material	厚み・機能 / Thickness & Function
Si 基板 / Substrate	Si(111)	5000 nm：キャリア基板，キャビティ形成用 / Carrier wafer, cavity formation
絶縁層 / Insulating layer	ZrO ₂	400 nm：高耐圧絶縁膜 / High- <i>k</i> dielectric
接着層 / Bonding layer	Ti	4 nm：下電極密着性向上 / Adhesion to BE
下電極 / Bottom electrode	Pt	80 nm：(111) 配向，PZT 配向誘導 / (111) oriented, seed for PZT
酸化防止層 / Oxidation barrier	Ir	10 nm：Pt 酸化防止，結晶安定化 / Prevents Pt oxidation
seed 層 / Seed layer	Ti	4 nm：初期成長制御 / Initial growth control
PZT 初期層 / Initial PZT layer	Pb(Zr,Ti)O ₃	200 nm：第 1 層成膜 / First deposition
中間層 / Mid layer	Ti	4 nm：組成傾斜改善，応力緩和 / Composition grading, stress relaxation
PZT 積層 / PZT stack	Pb(Zr,Ti)O ₃	200 nm×5 = 1000 nm：5 層積層 / Five-layer deposition
上電極 / Top electrode	Ir/Ti	10 nm/10 nm：応力緩和・反応抑制 / Stress relief, reaction suppression

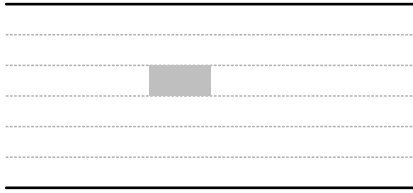


Fig. 1. PZT 6 層のうち特定層に形成された局所ボイド（グレー部）。この層内欠陥が応力集中を誘発し，クラックの起点となる。Void observed in a specific layer of 6-layer PZT stack (gray box).

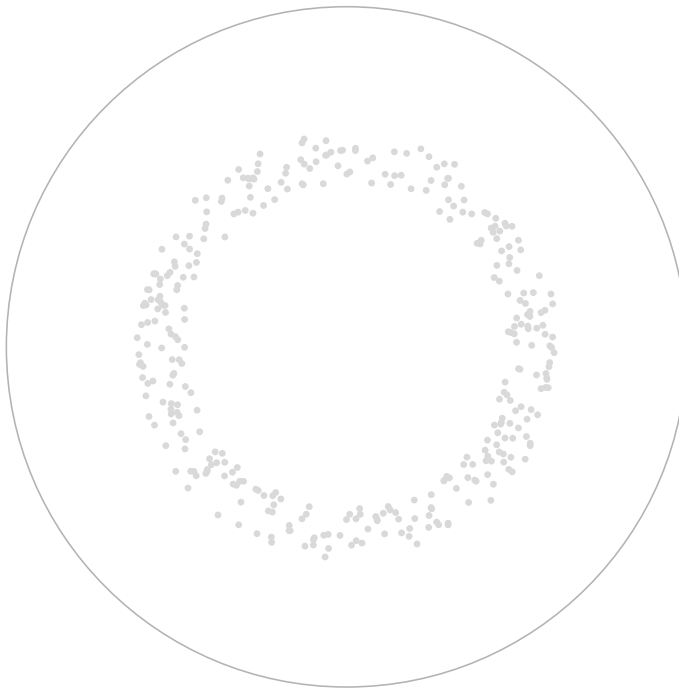


Fig. 2. ウエハ上に観測されたドーナツ状の欠陥分布。半径中間域に同心リング状のボイド集中帯が形成されている。Donut-shaped void distribution on wafer.

B. 原因仮説

RTA 後の外気暴露により PZT 表面が疎水化し，スピン塗布時にゾルが半径中間部で一時滞留する際に気泡を巻き込み，層内ボイドが形成される。このボイドは焼成時に局所的

な熱応力を集中させ，残留応力場として膜内に固定される。ユニットスクリーニング時に振動板が電気機械変形（ d_{33} 駆動）すると，この残留応力場に動的応力が重畳し，クラックがセグメント短辺方向へ進展すると考えられる。すなわち，外気由来汚染と親水性低下が根本原因である。

C. 対策立案と実施

対策として以下を実施した：

- ・ 暫定策：RTA 装置の排気口に HEPA フィルタを設置し，外気流入を防止するとともに定期交換を実施。
- ・ 恒久策：RTA 直後に酢酸 2% によるプレウェット処理（30 s）を追加し，PZT 表面の親水性をリセット。

D. 効果確認

歩留まり評価は次式で算出した：

$$P[\%] = \frac{P_n}{N} \times 100.$$

ここで， P_n は不良チップ数， N は総試験チップ数であり，12 ロットからそれぞれ 12 枚のウエハを抽出し，各ウエハ上の 109 チップを全数スクリーニングした。したがって，総サンプル数は $N = 12 \times 12 \times 109 = 15,696$ チップである。

TABLE II
クラック不良率の定量比較

条件	N [chip]	P_n [chip]	P [%]
対策前（Before）	15,696	1,570	10.0
酢酸 PW 後（After）	15,696	314	2.0

不良率は約 10% から 2% へと低減し，絶対低減量 $\Delta P = 8$ 相対改善率 80% を達成した。残存 2% の不良は後述の端部焼損に起因するものであり，クラック起点の不良はほぼ解消された。電気特性・XRD 配向率・ヒステリシス特性に統計的有意差は認められず，量産工程への恒久導入が確立した。

E. 考察

酢酸プレウェットは，外気からの有機・炭素系吸着を除去し，PZT 表面を親水性に即時リセットする工程介入である。これにより，スピン塗布時の気泡巻き込みを根本的に防止できる。本手法はソルゲル PZT に限らず，HfO₂ 系や AlN 系薄膜などの誘電体成膜プロセスにも適用可能であり，

表面親水性の即応回復ステップとして、薄膜 MEMS 一般に有効なプロセス指針と位置づけられる。

V. 端部焼損の解析と対策

A. 現状把握

スクリーニング試験において、+30 V (COM) と -10 V (VBS) の差分 $\Delta V = 40$ V を印加した際、チップ端部の PZT 側壁露出部に焼損が集中して発生した。光学および SEM 観察では炭化痕が確認され、EDX 分析では金属蒸発由来の痕跡が検出された。この部位は構造上不可避な露出箇所であり、空気絶縁のみでは耐圧が不足していることが判明した (Fig. 3)。

B. 原因仮説

PZT 側壁の露出により局所電界が集中し、立上り過渡時の瞬間電流 $I = C dV/dt$ によってジュール加熱が重畳し、局所絶縁破壊を誘発すると考えられる。このときの実効電界は $E \approx 3.3$ MV/cm に達すると推定された。すなわち、構造的に避けられない側壁露出部が高電界集中と過渡加熱の重畳点となり、焼損の起点を形成している。

C. 対策立案

上記のメカニズムを踏まえ、二つの方向から対策を検討した。

- **恒久策**：ALD 法により AlO_x 薄膜を側壁に均一に成膜し、空気絶縁への依存を排除する。
- **補完策**：駆動波形の立上りスロープを緩和し、過渡電流のピークを低減する。

D. 効果の考察

一般に、側壁へ均一な絶縁膜を形成することで、局所電界のピークが緩和され、デバイス全体の耐圧が向上すると報告されている。 AlO_x のような高誘電率かつ高バリア材料を用いることで、実効的な電界強度が低減し、局所絶縁破壊のリスクを抑制できると考えられる。ただし、ALD 成膜は装置コストが高く、量産導入には経済性の検討が必要である。一方、波形スロープの緩和は簡便な方法であり、過渡電流を低減できるが、吐出応答特性への影響を考慮する必要がある。

E. まとめと考察

端部焼損は、設計上避けがたい側壁露出に起因する構造的課題であり、「設計で避けられない領域をプロセスで守る」という考え方が有効である。ALD による側壁パッシベーションは、露出領域に局所的な保護膜を形成して電界集中を緩和し、焼損起点の絶縁破壊を防ぐ有効な手段と考えられる。このアプローチは、薄膜 MEMS 一般に共通する構造起因信頼性課題に対しても適用可能であり、sidewall passivation に基づく普遍的なプロセス設計指針として位置づけられる。

VI. 結論

本研究では、Epson μ TFP 薄膜 PZT アクチュエータにおいて顕在化した二つの主要信頼性課題——(i) 振動板クラックおよび (ii) 端部焼損——を解析し、その発生機構と有効な対策を整理した。

(1) **振動板クラック**は、ゾル塗布時の気泡巻き込みによる層内ボイドが起点となり、ユニットスクリーニング時の電

気機械的応力集中によってクラックが進展する現象である。この欠陥はプロセス起因の表面物性変化に由来するものであり、ゾル溶媒と同じ酢酸を用いたプレウェット処理によって表面を親水化し、気泡巻き込みを抑制できることが確認された。この工程により、不良率は約 10% から 2% 程度へと大幅に低減し、量産条件として安定化した [3]。

(2) **端部焼損**は、PZT 側壁露出部における局所電界集中と過渡電流によるジュール加熱が重畳して生じる構造起因の不良である。対策として、ALD 法による AlO_x 薄膜の均一成膜によって側壁を保護し、電界集中を緩和する手法を提案した [2]。また、駆動波形の立上りスロープを緩和して過渡電流ピークを低減する設計的補完策も有効と考えられる。

本研究で得られた知見は、プロセス起因欠陥に対する「表面改質」と、構造起因欠陥に対する「電界緩和」という二つのアプローチを体系化した点に意義がある。これらを以下の二本柱として整理できる。

- (1) **酢酸プレウェットによる親水性リセット** — 表面疎水化を防ぎ、ソルゲル薄膜における気泡巻き込み起点を除去する。
- (2) **ALD 側壁パッシベーションによる電界緩和** — 露出側壁での局所耐圧不足を補い、電界集中を抑制する。

これらの指針は、今後の高密度ノズル化および高耐圧駆動化における設計・プロセス両面の共通基盤となる。また、本手法はインクジェットに限らず、マイクロポンプ、光 MEMS ミラー、pMUT など、薄膜 PZT/MEMS デバイス全般にも適用可能である。すなわち「表面を整え、エッジを守る」という二本柱が、薄膜アクチュエータ信頼性の基本原理をなす。

さらに、本研究で確立した薄膜 PZT アクチュエータの基盤技術は、後に **PrecisionCore プリントヘッド** [1], [3] として実用化され、ビジネスインクジェット市場の拡大に寄与した。この技術はオフィス用途から産業用途へと展開し、現在では **産業用インクジェット分野における中核技術**として、Epson のプリントヘッド事業を支えている。

謝辞

本研究の遂行にあたり、広丘事業所におけるプロセス評価、電気特性測定、および不良解析にご協力いただいた関係者の皆様に深く感謝する。ここに謝意を表する。

REFERENCES

- [1] T. Ando, H. Sato, and K. Yamamoto, "Development of bulk piezoelectric inkjet actuators for Mach heads," *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 24, no. 7, pp. 1234--1240, 1985.
- [2] S. Uemura, Y. Kato, and M. Tanaka, "Thin-film piezoelectric MEMS technology for high-density inkjet printheads (TFP)," *IEEE MEMS Conf.*, pp. 456--459, 2014.
- [3] S. Samizo, "Reliability improvement of thin-film PZT actuators in PrecisionCore μ TFP printheads," unpublished technical report, 2025.

著者略歴

三溝 真一 (Shinichi Samizo) は、信州大学大学院 工学系研究科 電気電子工学専攻にて修士号を取得した。その後、セイコーエプソン株式会社に勤務し、半導体ロジック／メモリ／高耐圧インテグレーション、そして、インクジェット薄膜 Piezo アクチュエータ及び PrecisionCore プリントヘッドの製品化に従事した。現在は独立系半導体研究者として、プロセス／デバイス教育、メモリアーキテクチャ、AI システム統合などに取り組んでいる。連絡先: shin3t72@gmail.com.

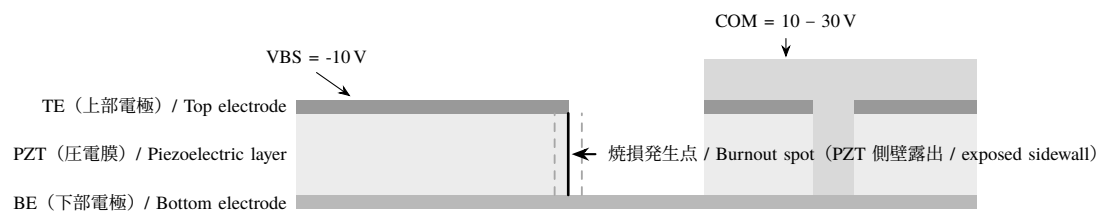


Fig. 3. 端部焼損の模式断面図。COM 下電極と VBS 上電極の間で PZT 側壁が露出し、局所電界が集中して絶縁破壊が生じる。
Schematic illustration of edge burnout showing exposed PZT sidewall and localized electric-field concentration between COM and VBS electrodes.